This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩ 日 本 国 特 計 庁 (JP) ⑪実用新案出願公開

®Int. Cl. 5

❷公開 平成2年(1990)1月11日

H 03 B 5/32

6832-5 J Н

`審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

❷考案の名称 水晶発振器

②実 願 昭63-81411

②出 願 昭63(1988) 6月20日

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 工藤明仁 @考案。者

株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

砂代 理 人 弁理士 碳村 雅俊

明細書

- 考案の名称
 水晶発振器
- 2. 実用新案登録請求の範囲

1. 半導体発振回路素子と水晶振動子とを同一プラスチックパッケージに封入して構成する水晶発振器において、ガラス面を有する角型のケースに水晶片を封入して構成した水晶振動子と、金線の大力により、水晶振動子と電気のに接続した半導体発振回路素子とを開放というでは、パッケージングすることを特徴とする水晶発振器。

3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本考案は、水晶発振器に関し、特に、精度および信頼性が高い水晶発振器に関する。

〔從来技術〕

従来の水晶発振器は、パッケージに一度封入す

140

ると周波数調整が不可能な金属製のシリンダータ イプ水晶振動子、および半導体発振回路素子の組 み合わせによって構成されていた。

この場合、水晶振動子自体の周波数は、一度調整すると固定されるため、半導体発振回路素子の容量パラツキにより、その発振周波数も大きなパラツキを生じてしまう。

このため、高桁度の水晶発振器を歩留り良く製造することは難しかった。

また、従来使用していた水晶振動子はシリンダータイプであるため、電気的接続を行うリードは 均一性の点で問題があり、自動接続が難しく、工 数が増えて髙価になるという問題があった。

なお、水晶発振器については、例えば"電子情報通信ハンドブック(1988年),電子情報通信学会編,オーム社"において述べられている。

(考案が解決しようとする課題)

上記従来技術では、高精度および髙信頼性を有する水品発振器を効率良く製造することは難しかった。

本考案の目的は、このような問題点を改善し、 高精度および高信頼性を有し、安価に効率良く側 造できる水晶発振器を提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

〔作用〕

本考案においては、パッケージングされる前の 製造工程で水晶振動子を発振させ、半導体発振回 路素子との間で周波数調整を行う。

この場合、レーザー光により、水晶振動子のガラス板を通して錘りを削り取る。

これにより、製造工程で容易に周波数調整を行い、精度および信頼性が高い水晶発振器を得ることができる。

〔実施例〕

以下、本考案の一実施例を図面により説明する。 第1図は、本考案の第1の実施例における水晶 発振器の製造工程での概観を示す斜視図、第2図 は本考案の第1の実施例における水晶振動子の断 面図である。

本実施例では、第1図のように、製造工程の途中段階における水晶発振器は、リードフレーム1上に設置されて、半導体発振回路素子(ICチップ)12、水晶振動子13、および金線ワイヤ15を備える。

このリードフレーム11は、半導体発振回路素子12や水晶振動子13の脱落を防ぎ、また金線ワイヤ15の切れを防いで、実装工程を通過した後に切断される。

また、水晶振動子13は、第2回のように、電極パターン14、セラミック製の容器21、ガラス板22、水晶片23、錘り24、およびシール材25から構成される。

また、I C チップ12は、電源端子16および 出力端子17を有し、水晶振動子13を発振させ るためのものであり、その製造方法は一般に知ら れている。

また、金線ワイヤ15は、I C チップ12と水 晶発振器13とを電気的に接続する。

このような構成により、本実施例では、製造工程において電源端子16および出力端子17にプローブ18を立て、電源端子16に電圧を加えることによって水晶振動子13を発振させる。これにより、出力端子17にカウンタ(図示せず)を接続して発振周波数を読み取る。

この発振周波数を修正する必要がある場合には、 この状態で水晶振動子13のガラス板22を通し て、矢印で示すようにレーザー光を照射し、錘り 24を削除することによって周波数を変化させ、





所望する値に合わせる。

このように、同一パッケージングの I C 発振により水晶振動子 1 3 の周波数を調整できるため、 製造工程で容易に高精度・高信頼性を達成することができる。また、角型の水晶振動子を金線ワイヤで接続することにより、自動接続を行ってパッケージングを自動化することができる。

第3回は、本考案の第2の実施例における水晶 飛掘器の製造工程での概観を示す斜視図である。

本実施例の水晶発振器は、リードフレーム11 を境にして、1 C チップ12 の下方に水晶振動子 13を配置している。この場合も、第1 の実施例 と同様にI C チップ12 と水晶振動子13 は電気 的に接続されており、周波数を合わせる際はプロ ービングにより行う。

第4図は、本考案の第3の実施例における水晶 発振器の製造工程での概観を示す斜視図である。

本実施例の水品発掘器は、水晶振動子13の上にICチップ12を重ねて配置している。この場合も、第1の実施例と同様にICチップ12と水

晶振動子13は電気的に接続されており、周波数を合わせる際はプロービングにより行う。

〔考案の効果〕

本考案によれば、同一パッケージングされた半導体発振回路素子と水晶振動子との発振周波数調整であるため、合わせ込み精度が高い水晶発振器を歩留り良く製造することができる。

また、一部透明部分(ガラス板)を有する水晶振動子を用いているため、レーザー光によって錘りを簡単に削ることができ、調整が容易である。

また、水晶振動子の形状が立方体であり、パッケージング方法を容易に自動化することができる ため、安価な製品を供給することができる。

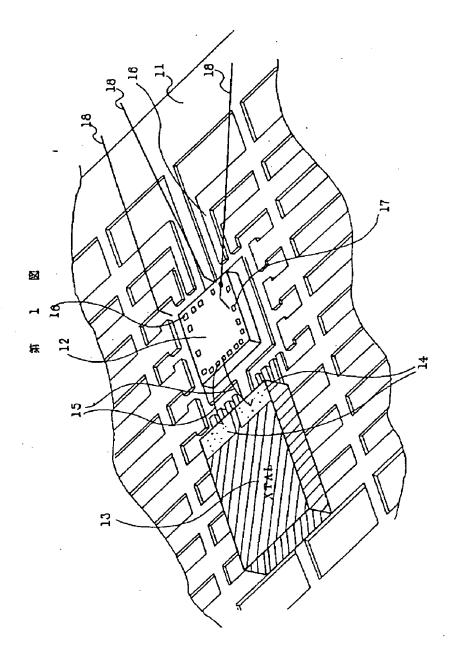
4.図面の簡単な説明

第1図は本考案の第1の実施例における水晶発 振器の製造工程での概観を示す斜視図、第2図は 本考案の第1の実施例における水晶振動子の断面 図、第3図は本考案の第2の実施例における水晶 発振器の製造工程での概観を示す斜視図、第4図 は本考案の第3の実施例における水晶発振器の製造工程での概観を示す斜視図、第4図

造工程での概観を示す斜視図である。

11:リードフレーム,12:半導体発振回路 素子(ICチップ),13:水晶振動子,14:電 極パターン,15:金線ワイヤ,16:電源端子, 17:出力端子,18:プローブ,21:セラミ ック製の容器,22:ガラス板,23:水晶片, 24:錘り,25:シール材。

実用新案登録出顧人 株式会社 リ コー 代理人 弁理士 酸 材 雅 俊

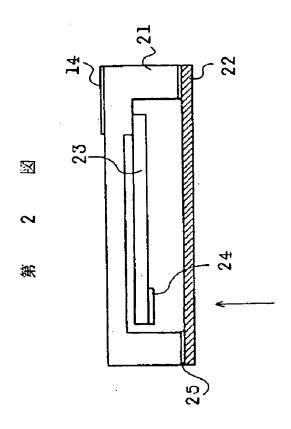


実用新築登録出題人 本式会社 リ ロー

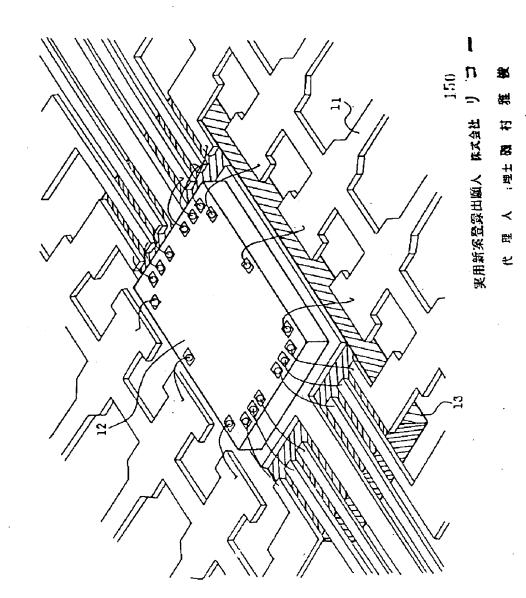
代 国 人 年度士 職 村 雅 彼

148

を見しく目が



実用新案登録出願人 株式会社 リ コ ー 代 理 人 弁理士 磯 村 雅 俊 149

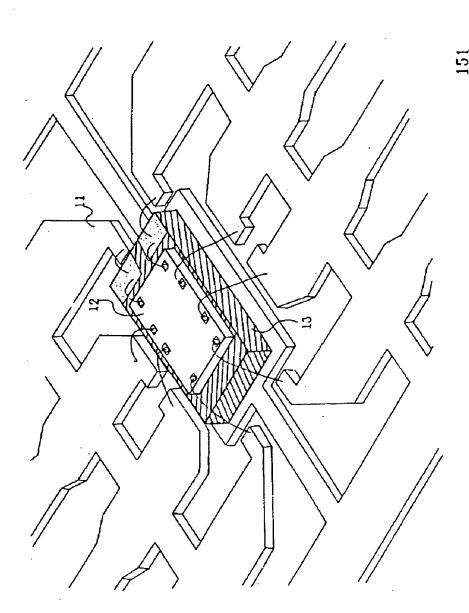


ま 記 88

実用新案登録出顧人 陈式会社

序型士 跟村

未用人



4

Ø